

水基环保清洗剂DFL-N900

TDS 技术数据表

说明:

DFL-N900是一款新型环保水基型清洗剂，专门用于可靠性要求高的电子组装产品（PCBA）和半导体封装器件焊锡膏、助焊剂的清洗。可有效去除有铅或无铅焊料、松香焊料、免洗和粘性助焊剂等不同类型的顽固助焊剂残留物。同时，具有较高的污物负载能力和较长的使用寿命。

DFL-N900适用于浸入式如超声、喷流、浸洗等多种不同清洗方式。

特点与优势:

清洗性能	可清洗多种有铅/无铅焊料中诸如松香型、免洗或者粘性助焊剂残留物。
	特别适用半导体厚膜电路和BGA/Flip chip等细小间距器件助焊剂残留清洗。
	中性，无腐蚀性；无泡沫，易漂洗。
	清洗能力强、寿命长，洁净度高，适用于高要求、先进封装、混合电路和SMT基板。替代进口同类产品，性能品质完美胜任，成本更惠。
环保健康安全  HMIS=1-2-0	高闪点，使用操作安全。
	气味低，对人体安全。使用过程无需特殊的防护措施。
	不含ODS和卤素成分，不损坏大气臭氧层。
	环境友好，可生物降解。完全满足欧盟环保标准，包括ROHS&WEEE, REACH指令等。
	
经济性	具有较高的污物负载能力和较长的使用寿命，性价比高。

应用范围:

+++强烈推荐 ++中度推荐 +一般推荐

清洗对象	污染物	推荐使用
印刷线路板/组装板（PCBA）	助焊剂残留	+++
厚膜器件/陶瓷基板	助焊剂残留	++
功率器件/引线框架	助焊剂残留	+++
倒装芯片/BGA器件	助焊剂残留	+++
其他	灰尘、颗粒等	++

工艺参数:

工艺	清洗>	漂洗>	烘干
超声波	N900	去离子水或纯水	循环热风
喷流	N900	去离子水或纯水	循环热风
离心式	N900	去离子水或纯水	循环热风

N900推荐浓缩原液直接使用，稀释液在温度50±5℃浸泡20到30分钟，再用清水（纯净水、去离子水更佳）漂洗二次，至板面洁净即可。（详细推荐清洗工艺参数表可另外联系本公司索取）。

然后在80-100℃热风干燥炉或箱中干燥至板面完全无水份或湿气止。

人工手动漂洗，须涮洗两次；机器漂洗须两个槽漂洗，带超声波更佳。

参考清洁度标准: 组装线路板清洗适合以下清洁度标准

1	IPC-A-610	目检洁净度标准
2	J-STD 001	离子污染度标准
3	IPC-TM 650 和 DIN 32513	表面阻值标准
4	J-STD 003	可焊性标准

物理化学性能与技术参数:

属性	单位	数值*
外观	目观	清澈, 透明液体
密度, 20°C	g/ccm,20°C	0.95 ± 0.05
表面张力	mN/m,25°C	29.0
沸程	°C	95°C-233°C
闪点	°C	无
饱和蒸汽压, 20°C	mbar 20°C	0.47
pH值	10g/L H ₂ O	7.0±0.5
清洗温度	°C	40-60
在水中溶解性	-	完全可溶
应用浓度	直接使用液	100%
HMIS	Health-Flammability-Reactivity	1-2-0

包装:

DFL-N900包装为20KG的直接使用液标准包装。

DFL-N900为非危险品, 无需特别标识。

储存:

DFL-N900为非危险化学品, 其所有组分不在美国TSCA法规管控之内。

该产品可用高密度聚乙烯材料的容器盛放, 适宜的贮存温度为4°C-50°C。在工厂原始未开启的包装状态下, 具有至少5年的使用有效期。

请参考材料安全数据单以获得更多的建议信息。

危害标识:

使用本产品前请阅读材料安全数据单。本品为非危险化学品, 无需特别标识。 请按照材料安全数据单中的规定操作和处理本产品。

采购信息:

采购物料编码	采购物料名称	采购型号	包装	使用状态
N900	水基环保清洗剂	DFL-N900	20KG/桶	直接使用

声明:

本技术资料中的所有信息是基于我们现有知识水平的理解和真实、准确描述, 因实际使用状况可能超出我们的控制, 我们对于所陈述的意见、建议等并不作保证。而且, 这里所有的信息不构成对使用任何与现行专利冲突的、含有任何物质及其应用的产品的建议。

深圳市东方亮化学材料有限公司

深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼6K

电话0755-27322821: 微信: 18823672018